

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
3. Juni 2004 (03.06.2004)

PCT

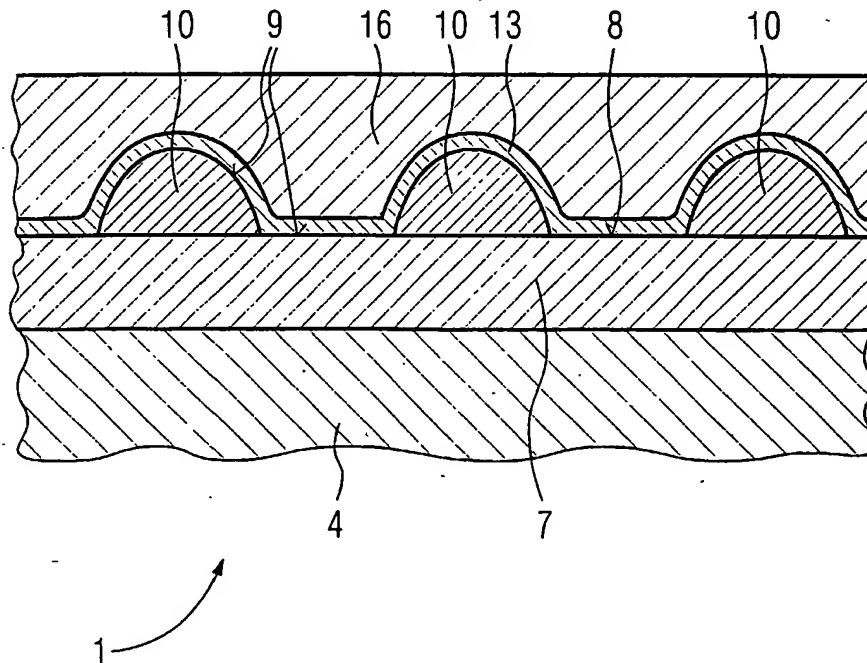
(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2004/045844 A1**

- (51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: **B32B 15/00**, 18/00, F01D 5/00, C25D 15/02, C23C 4/02, F01D 5/28
- (72) Erfinder; und  
(75) Erfinder/Anmelder (*nur für US*): **HALBERSTADT, Knut** [DE/DE]; Nachbarsweg 80, 45481 Mülheim a.d. Ruhr (DE). **STAMM, Werner** [DE/DE]; Kahlenberg 18, 45481 Mülheim a.d. Ruhr (DE).
- (21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/EP2003/012095**
- (22) Internationales Anmeldedatum:  
30. Oktober 2003 (30.10.2003)
- (74) Gemeinsamer Vertreter: **SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT**; Postfach 22 16 34, 80506 München (DE).
- (25) Einreichungssprache: **Deutsch**
- (26) Veröffentlichungssprache: **Deutsch**
- (81) Bestimmungsstaaten (*national*): **CN, JP, US.**
- (30) Angaben zur Priorität:  
02026012.1 21. November 2002 (21.11.2002) **EP**
- (84) Bestimmungsstaaten (*regional*): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).
- (71) Anmelder (*für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US*): **SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT** [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).
- Veröffentlicht:  
— mit internationalem Recherchenbericht

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: **LAYER SYSTEM**

(54) Bezeichnung: **SCHICHTSYSTEM**



(57) Abstract: In layer systems according to prior art, the adhesion between the layers or between the layers and the substrate is often poor. In the inventive layer system (1), the surface of the interface (9) between the layers is enlarged such that the connection and adhesion are improved.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2004/045844 A1